

# SEMICON Japan 2026　出展のお知らせ

2026年12月9日（水）～ 12月11日（金）

於：東京ビッグサイト　東7ホール　　トルンプ株式会社　ブース番号 E7702

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
弊社は12月に開催される「SEMICON Japan 2026」に出展いたします。半導体アドバンスパッケージ向けのプラズマ電源ソリューションとレーザ技術について最新情報を展示するとともに、お客様のご相談を承ります。
皆さまのお立ちよりをお待ちしております。　敬具

2026年11月吉日

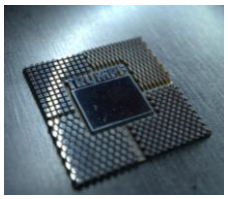
トルンプ株式会社 エレクトロニクス事業部・レーザ事業部 事業部長
クルーゼ・ガブリエル

## 出展のみどころ
## トルンプの半導体アドバンスパッケージ向けソリューション

レーザ技術によるウェハーダイシング、クーリングプレート加工、TGV向けソリューション、 HIPIMS向けパルスDC電源などトルンプの半導体アドバンスパッケージ向けソリューションを提案します。

### 【注目！】加工サンプル展示

・TGV微細加工サンプル
・ウェーハーダイシング加工サンプル
・クーリングプレート



### 【注目！】高出力パルスDC電源の実機展示

・HIPIMS向け　「TruPlasma Highpulse シリーズ 4000 (G2)」



### ■ご入場方法：入場無料

展示会主催者サイトから事前入場登録・バッジ印刷（モノクロ）をお願いします。
https://www.semiconjapan.org/jp　（外部サイトへ遷移します）

**トルンプ株式会社 エレクトロニクス事業部・レーザ事業部**
〒226-0006 横浜市緑区白山1-18-2
info@jp.trumpf.com
www.trumpf.com